

证券代码: 688591

证券简称: 泰凌微

公告编号: 2025-027

泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于端侧AI新品推广的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

随着客户对芯片端侧AI集成能力需求的不断增长，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）积极投入研发，2024年底成功推出了新一代的同时支持端侧AI和多项物联网无线连接技术的芯片产品，产品推出后凭借卓越性能与创新特性，迅速赢得了客户的青睐，并进入规模量产阶段，2025年二季度新产品的销售额已经达到人民币千万元规模，端侧AI新品的推广取得阶段性成果。

为便于广大投资者了解公司端侧AI新品的推广情况，现将情况披露如下：

一、市场拓展情况: 提供芯片、模块与AI软硬件开发平台与解决方案

针对客户对于芯片端侧AI能力集成需求的快速增长，以及AIOT产品多元化的发展趋势，公司战略性地布局了不同系列的芯片产品线并配套了相对应的模块。新产品集成了先进的端侧AI运算能力，支持多种物联网无线连接协议。

TL721X系列以其1mA超低功耗，成为业界领先的低功耗端侧AI多协议物联网无线SoC芯片，满足了新一代智能物联网终端产品对超低功耗的AI算力和多种无线连接的高标准要求。

TL751X系列则通过其高性能、多协议和高集成度，结合先进的多核设计包括CPU、NPU和DSP，提供了强大的AI运算处理能力和几乎所有主流物联网无线连接协议（BLE、Zigbee、Thread、Matter等）的支持，适用于各种智能无线物联网和无线音频SoC等领域。

上述两款TL7系列芯片是国内最早通过最新的BLE6.0蓝牙协议认证的芯片产品。公司同时提供面向广大开发者的基于这两款芯片的TL-EdgeAI开发平台，支持包括谷歌LiteRT、TVM、PyTorch等在内的主流端侧AI模型，客户只需几个小时就可以把训练好的AI模型植入公司芯片内并且实现所需的AI功能。这是全球行业内功耗最低的智能物联网连接协议平台之一，特别适合各类电池供电的

智能产品，为AI端侧应用的发展提供巨大助力，使蓝牙等物联网无线连接芯片脱离了传统无线通讯芯片的单一传输功能，实现了可自行学习，可参与、对接大模型和应用小模型。公司近期还将推出以TL721X为基础的认证模块，进一步帮助客户缩短开发时程，加速产品上市时间 (Time-to-Market)。

二、市场影响：稳健布局、持续成长

此次端侧AI新品实现规模销售，标志着公司在融合机器学习及人工智能软硬件技术、拓展端侧AI应用市场等方面取得了实质性进展。通过提供低功耗、高性能的端侧AI解决方案，公司推动了智能音频、智能家居和智能办公等应用领域的技术革新，加速了端侧AI技术在终端设备上的普及和应用。

公司在2024年12月正式推出TL721X和TL751X产品后，很快就有无线音频、智能家居、智能穿戴、运动监测等多个领域的客户开始导入产品，并进入规模量产阶段，今年二季度TL7系列产品就已经实现了人民币千万元规模的营业收入。TL7系列SOC新产品凭借其卓越性能与创新特性，有望帮助公司在新的端侧AI领域获得更大的市场份额，加深与众多国内外一线品牌的深度合作，推动公司业务的持续扩展和优化，进一步增强公司的核心竞争力。

三、风险提示

目前，公司端侧AI新品虽已成功开始出货，但整体出货量尚在初期上升阶段，现阶段占公司营收比例仍较低，后续销售情况将受客户方案进展、市场拓展及竞争情况等多种因素影响而具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2025年6月24日